

2-1-2-15 鉄基板 SR 引抜擦り傷 / 铁基板的 SR 拉伤 / Scratch on solder resist of iron-base board by board pulling

【特徴】鉄基板のSR表面の比較的浅い引きずり傷、傷部が錆びている場合あり

【特征】鉄基板的SR表面有比较浅的拉伤，伤痕有时氧化。

【Characteristics】A relatively shallow scratch on the solder resist surface on an iron-base printed board. Scratched part is often rusted.

【原因・判断ポイント・発生工程】高く積み重ねたボードの中から一部のボードを無理に引き抜いたことにより出来たもの（SR塗布乾燥後工程）

【原因、判断要点、发生工序】板件从堆垛中硬拉出来而引起的（SR涂布烘干后工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】The scratch is formed by pulling out one or some boards forcibly from a high stack of boards. (After solder resist application process)



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率×

【Comments】Magnification: ×

【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率×

【Comments】Magnification: ×

2-1-2-16 SR 滴下付着 / SR 的滴下并附着 / Drop of solder resist ink

【特徴】表面に滴下した様相で、付着しているSR汚れ欠陥

【特征】在表面有滴下的模样，附着的SR沾污的缺陷。

【Characteristics】Dirty solder resist surface caused by a drop of solder resist ink

【原因・判断ポイント・発生工程】SR塗布後の表面に液状のSRインクを誤って滴下させてしまったことにより出来たもの（SR塗布乾燥後工程）

【原因、判断要点、发生工序】错误地将液体的SR滴下到SR烘干表面所引起的（SR烘干后工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】Liquid solder resist ink is carelessly dropped on the coated solder resist surface (After solder resist application process)



【コメント】顕微鏡倍率×10

【注釋】显微镜倍率×10

【Comments】Magnification: ×10



【コメント】顕微鏡倍率×40

【注釋】显微镜倍率×40

【Comments】Magnification: ×40